下载日志已记录，仅供内部参考

策略研究

策略专题报告

证券研究报告

国产建设加速，聚焦半导体制造与材料

■ 国泰海通策略主题风向标 20260927

方奕(分析师)
021-38031658
fangyi2@gtht.com
登记编号 S0880520120005

苏徽(分析师)
021-38676434
suhui@gtht.com
登记编号 S0880516080006

本报告导读：

热点主题交易热度维持低位，黄酒/医药/地产相关主题领涨，有色资源品主题回调。主题结构扩散且轮动加快，看好国产半导体/自主新技术/先进材料/AI4S。

投资要点：

- **主题温度计：热点主题交易热度维持低位，黄酒/医药/地产相关主题领涨，有色资源品主题回调。**上周热点主题日均成交额平均 8.34 亿元，日均换手率 3.28%，延续低位水平。本期热点主题波动收敛，黄酒/医药/地产主题领涨，传媒/冰雪旅游主题热度提升，而黄金/六氟化钨/工业金属等回调，主题资金活跃度下降。海外流动性与地缘风险反复，AI 产业叙事分歧加大，叠加假期来临，市场成交量萎缩，主题结构扩散且轮动加快，新技术加速应用与国内稳投资力度加码有望成为持续催化，看好国内算力网投资与自主新技术应用。
- **主题一：国产半导体。**政策密度、投资强度与项目进度共振，2027 年我国算力网建设有望加速。国常会多次部署“六张网”建设，国家发改委密集推进相关投融资机制、政银企协作机制、项目库建设与重大项目落地工作。“十五五”时期我国算力网建设将新增直接投资 4 万亿元，多地算力重大项目加速落地。“国模国芯”模式下国产大模型加速适配国产算力生态，地缘博弈加速“卡脖子”环节国产化与超节点等自主新技术应用。国内算力网建设加速有望拉动国产半导体产业链需求。**推荐：**1、受益大规模智算集群建设的国产 GPU；2、国产化水平持续提升的半导体制造、先进封装与关键设备。
- **主题二：自主新技术。**华为发布全球首个采用 NPO 技术的昇腾 960 超节点，加速十万亿规模的大模型训练和推理。超节点成为 Agentic AI 时代算力基础设施的主流形态。华为昇腾 384 超节点已商用落地 750 多套，规模应用于互联网/运营商/金融/教育/医疗/交通/制造等行业。在 Scale up 与 Scale out 的演进过程中，光互联需求发生显著变化，Scale up 采用共封装光学（CPO）、近封装光学（NPO）等将光引擎与计算芯片共封装，以降低时延、提高带宽密度。**推荐：**1、受益国内超节点商用落地的交换芯片/交换机/服务器等；2、受益 Scale up 光互联需求拉动的 NPO 与 CPO 供应链。
- **主题三：先进材料。**全球半导体材料市场需求高增，中国大陆半导体材料收入增速与规模保持领先，供给短缺与国产化成为核心催化。《电子信息制造业发展“十五五”规划》提出推动集成电路全链条攻关，推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展。据 SEMI，2025 年全球半导体材料市场销售额同比增长 6.8%，达到 732 亿美元。分区域看，中国台湾地区连续第 16 年领先，中国大陆以 156 亿美元销售额排名第二，但同比大增 12.5%领先全球。**推荐：**1、受益投资高增具备涨价动力的散热材料/覆铜板/电容材料等；2、受益国产化材料体系构建的光刻材料/大硅片/掩膜版/靶材等。
- **主题四：AI4S。**AI 工具加速驱动创新药物研发，产业投融资高热度。诺和诺德与 Anthropic 展开合作，利用 AI 工具推进药物研发。AI 能力不断提升，可以缩短新药研发周期、改善研发成果，并发现能够显著改善人类生活的药物和治疗方法。字节跳动分拆出来的 AI 制药公司 Anew Labs 完成首轮天使轮融资，融资金额 2.9 亿美元，投后估值达 15 亿美元。**推荐：**1、具备前沿模型开发能力的大模型公司；2、受益 AI 驱动药物研发的头部创新药企。
- **风险提示：**关键技术商业化进程低于预期，地缘政治相关风险。

相关报告

新兴产业投资的边界 2026.09.24
全球 AI 安全治理与中国 AI 建设进入加速期 2026.09.23
国产替代向纵深推进 2026.09.14
业绩增速提升，AI 与资源双轮驱动 2026.09.03
时代主线：中国本土创新与企业全球化 2026.09.01

下载日志已记录，仅供内部参考

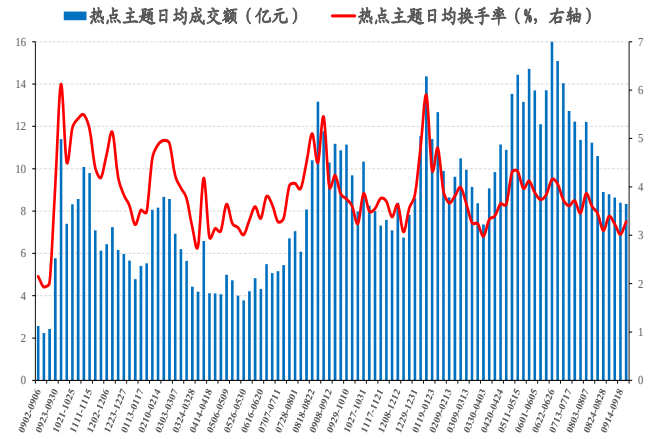
目录

一、主题温度计：热点主题交易热度维持低位，黄酒/医药/地产相关主题领涨，有色资源品主题回调.....3
二、本期重点推荐主题：国产半导体/自主新技术/先进材料/AI4S.....4
主题一：国产半导体---国产投入与建设将在 2027 年加速，国产算力集群加速适配大模型推理需求，叠加算力网建设有望提速，看好国产算力与先进半导体制造产业链.....5
主题二：自主新技术---华为发布全球首个采用 NPO 技术的昇腾 960 超节点，催化新技术应用与配套体系升级，看好受益光互联需求的 NPO/CPO 与交换机/交换芯片.....7
主题三：先进材料---半导体制造需求高增与关键材料出口管控，催化价格上涨与加速先进材料体系国产化，看好散热材料/光刻材料/大硅片/掩膜版等.....9
主题四：AI4S---AI 工具加速驱动创新药物研发，头部大模型公司加速布局，产业投融资高热度，看好具备前沿模型开发能力的模型公司与头部创新药企.....11
三、风险提示.....13

下载日志已记录，仅供内部参考

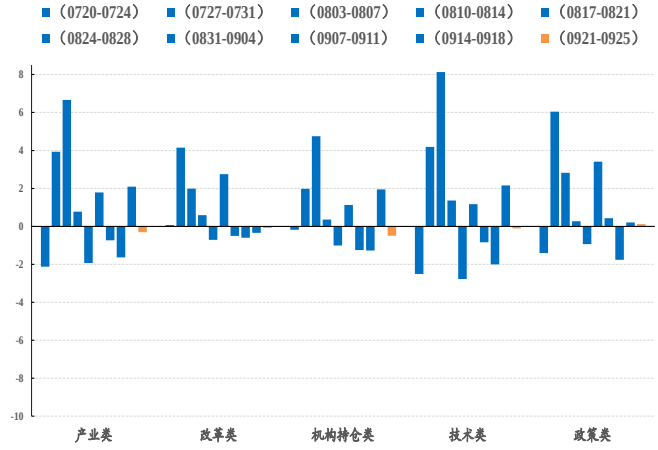
一、主题温度计：热点主题交易热度维持低位，黄酒/医药/地产相关主题领涨，有色资源品主题回调

图1：热点主题日均成交额与换手率维持低位震荡



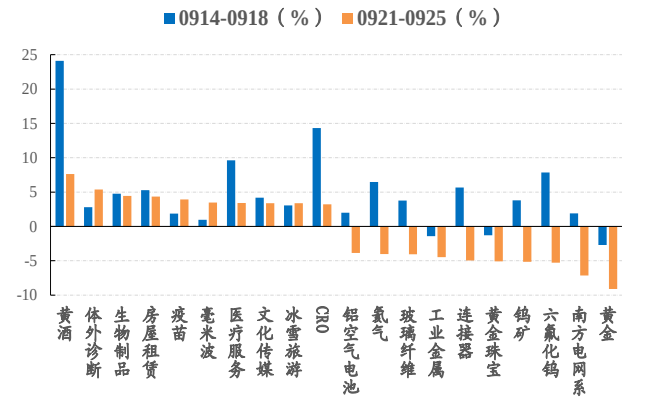
数据来源：Wind，国泰海通证券研究

图2：大类主题窄幅波动，科技类主题整体走弱（%）



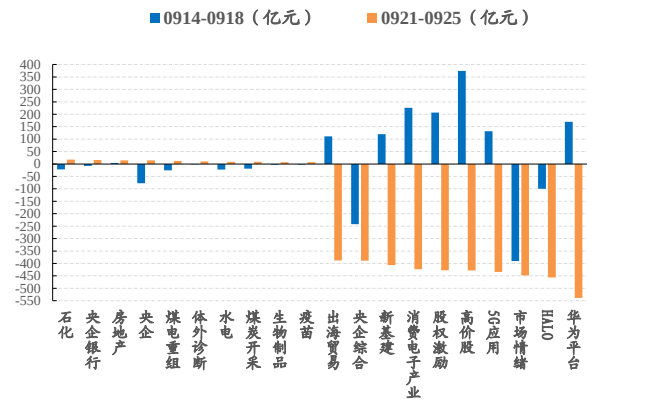
数据来源：Wind，国泰海通证券研究

图3：黄酒/医药/地产主题领涨，金属相关主题回调



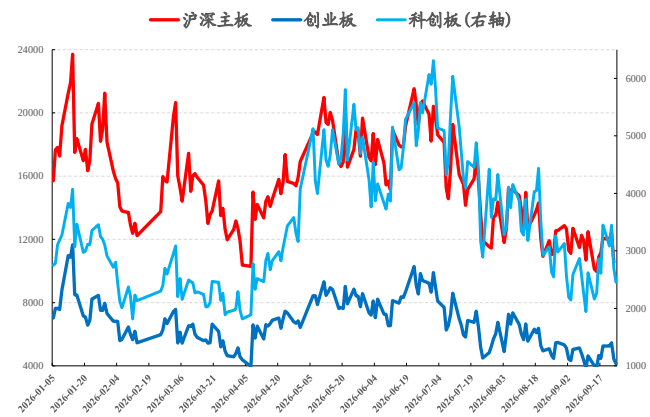
数据来源：Wind，国泰海通证券研究

图4：热点主题资金活跃度下降，小幅流向防御主题



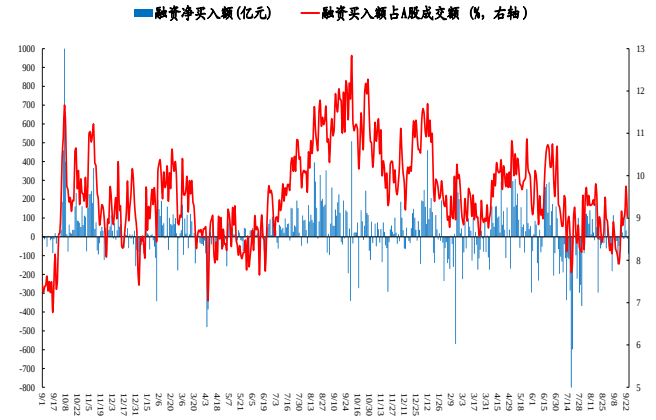
数据来源：Wind，国泰海通证券研究

图5：沪深主板与科创板/创业板成交额维持低位



数据来源：Wind，国泰海通证券研究

图6：两市融资买入额与融资成交占比冲高回落



数据来源：Wind，国泰海通证券研究

下载日志已记录，仅供内部参考

二、本期重点推荐主题：国产半导体/自主新技术/先进材料/ AI4S

1、国产半导体：国产投入与建设将在 2027 年加速，国产算力集群加速适配大模型推理需求，叠加算力网建设有望提速，看好国产算力与先进半导体制造产业链

投资建议：政策密度、投资强度与项目进度共振，2027 年我国算力网建设有望加速。国常会多次部署“六张网”建设，国家发改委密集推进相关投融资机制、政银企协作机制、项目库建设与重大项目落地工作。“十五五”时期我国算力网建设将新增直接投资 4 万亿元，多地算力重大项目加速落地，呼和浩特、乌兰察布两地密集签约 13 个项目，总投资额 1361 亿元。“国模国芯”模式下国产大模型加速适配国产算力生态，地缘博弈加速“卡脖子”环节国产化与超节点等自主新技术应用。国产算力集群加速适配国内前沿模型推理需求。**国内算力网建设加速有望拉动国产半导体产业链需求。**

推荐：1、受益大规模智算集群建设的国产 GPU；2、国产化水平持续提升的半导体制造、先进封装与刻蚀/测试等关键设备。

2、自主新技术：华为发布全球首个采用 NPO 技术的昇腾 960 超节点，催化新技术应用与配套体系升级，看好受益光互联需求的 NPO/CPO 与交换机/交换芯片

投资建议：华为发布全球首个采用 NPO 技术的昇腾 960 超节点，加速十万亿规模的大模型训练和推理。超节点成为 Agentic AI 时代算力基础设施的主流形态。更大规模 MoE 模型、更长上下文序列、更低推理时延等对算力及其基础设施提出前所未有的需求和挑战，超节点是应对这一系列挑战的关键所在。华为昇腾 384 超节点已商用落地 750 多套，规模应用于互联网、运营商、金融、教育、医疗、交通、制造等行业。昇腾 960 超节点采用正交架构和全液冷设计，加速前沿模型训练与推理创新。在 Scale up 与 Scale out 的演进过程中，光互联的需求发生了显著变化，Scale up 采用共封装光学（CPO）、近封装光学（NPO）等芯片级光互连技术，将光引擎与计算芯片共封装，以降低时延、提高带宽密度。

推荐：1、受益国内超节点商用落地的交换芯片/交换机/服务器等；2、受益 Scale up 光互联需求拉动的 NPO 与 CPO 供应链。

3、先进材料：半导体制造需求高增与关键材料出口管控，催化价格上涨与加速先进材料体系国产化，看好散热材料/光刻材料/大硅片/掩膜版等

投资建议：全球半导体材料市场需求高增，中国大陆半导体材料收入增速与规模保持领先，供给短缺与国产化成为核心催化。《电子信息制造业发展“十五五”规划》提出推动集成电路全链条攻关，推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展，持续提升关键装备、材料和零部件供给能力。日本进一步收紧对华高端制造业核心技术出口限制，材料龙头味之素拟向中国大陆客户削减 30% ABF 膜供货量。据 SEMI，2025 年全球半导体材料市场销售额同比增长 6.8%，达到 732 亿美元。分区域看，中国台湾地区连续第 16 年

下载日志已记录，仅供内部参考

保持全球最大半导体材料消费地区位置，中国大陆以 156 亿美元的销售额排名第二，但同比大增 12.5%领先全球。

推荐：1、受益半导体投资高增具备涨价动力的散热材料/覆铜板/电容材料等；2、受益国产化材料体系构建的光刻材料/大硅片/掩膜版/靶材等。

4、AI4S：AI 工具加速驱动创新药物研发，头部大模型公司加速布局，产业投融资高热度，看好具备前沿模型开发能力的模型公司与头部创新药企

投资建议：诺和诺德与 Anthropic 展开合作，利用 AI 工具推进药物研发，以加快新药发现和开发进程。AI 能力不断提升，可以缩短新药研发周期、改善研发成果，并发现能够显著改善人类生活的药物和治疗方法。字节跳动分拆出来的 AI 制药公司 Anew Labs 完成首轮天使轮融资，融资金额 2.9 亿美元，投后估值达 15 亿美元。Anthropic 密集布局生物科技领域，4 亿美元收购 Coefficient Bio，举办“AI for Science”发布会，赛诺菲、艾伯维、阿斯利康等头部药企均已部署了 Claude for Sciences。

推荐：1、具备前沿模型开发能力的大模型公司；2、受益 AI 驱动药物研发的头部创新药企。

主题一：国产半导体---国产投入与建设将在 2027 年加速，国产算力集群加速适配大模型推理需求，叠加算力网建设有望提速，看好国产算力与先进半导体制造产业链

事件：

1、2026 年 9 月 20 日，长鑫存储在 2026 世界制造业大会上正式宣布第五代 DRAM 技术平台实现量产，同步展出基于该平台打造的大容量 LPDDR5X 新品。G5 平台在关键工艺维度实现了多项行业领先的技术突破：依托创新的四重曝光技术把内存阵列的有源区半间距微缩至 11.95 纳米，接近全球最顶尖的内存量产平台制程；通过变革工艺流程、采用新材料，存储电容深宽比达 45:1；开发适配 DRAM 工艺的高介电常数金属栅（HKMG）工艺，成功将 G5 平台核心功能区高度缩小到 6762 纳米。（上海证券报）

2、2026 年 8 月 22 日， 2026 绿色算力（人工智能）大会在呼和浩特召开。签约环节中，呼和浩特、乌兰察布两地与火山引擎、寒武纪等头部企业集中签约 13 个项目，总投资额 1361 亿元。签约项目涵盖芯片检测、装备制造、算力中心、词元工厂等多个领域。（内蒙古日报）

政策密度、投资强度与项目进度共振，2027 年我国算力网建设有望加速。国常会多次部署“六张网”建设，国家发改委密集推进相关投融资机制、政银企协作机制、项目库建设与重大项目落地工作。“十五五”时期我国算力网建设将新增直接投资 4 万亿元，多地重大项目加速落地。**“国模国芯”模式下国产大模型加速适配国产算力生态，地缘博弈加速“卡脖子”环节国产化与超节点等自主新技术应用。**我国日均词元调用量突破 500 万亿，两年增长超千倍；国产算力集群加速适配国内前沿模型推理需求；华为昇腾 950 超节点已规模商用，发布业界首个使用 NPO 的昇腾 960 超节点。

下载日志已记录，仅供内部参考

从技术追随者到新技术路径定义者，国产创新重构半导体制造产业链，看好先进半导体制造、关键新材料与基础软件领域自主化水平加速提升。人工智能显著拉动算力/存储/制造等领域需求，新需求、新技术与国产化形成三重共振。智谱首次在大规模流量中尝试用大国产芯片集群提供服务，证明国产芯片完全可以在大规模场景下高效、经济地支撑前沿模型的推理需求。国内投资方面，六张网建设成为“十五五”开局之年的重要投资抓手，其中算力网、新型电网、新一代通信网协调机制的构建，有望加速 AI 基础设施投资落地，拉动国产半导体产业链需求。**推荐：**1、受益大规模智算集群建设的国产 GPU/超节点等；2、国产化水平持续提升的半导体制造、先进封装/刻蚀/测试设备；3、EDA/IP 授权/先进半导体材料。

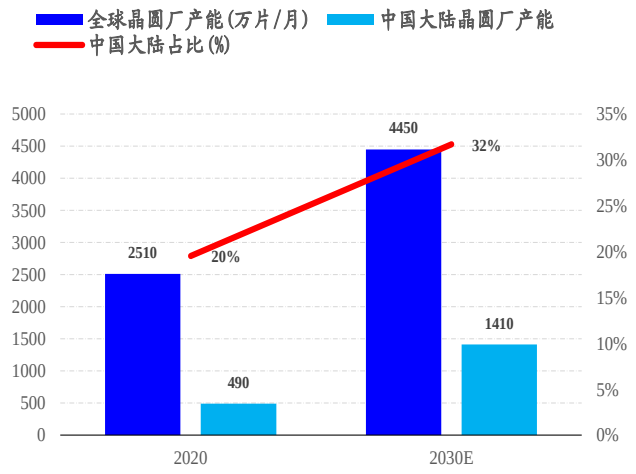
图7：国常会多次部署“六张网”建设，国家发改委密集推进相关投融资机制、政银企协作机制、项目库建设与重大项目落地工作

时间	会议	主要内容
2026年9月11日	**国务院常务会议**	**研究算力网建设有关工作。**会议指出，算力网是人工智能发展的基础支撑。**积极推进关键技术和装备研发应用，构建多层次网络化算力体系。**要推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，强化算电设施规划衔接，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。
2026年7月31日	**国务院常务会议**	**加快实施“十五五”规划确定的重大项目，扎实推进“六张网”规划建设。**会议指出，要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进。
2026年7月20日	**国务院常务会议**	**推动服务业扩能提质和“六张网”规划建设对于稳投资、扩消费、惠民生具有重要意义。**要系统推进“六张网”规划建设，因地因业加快实施，加强资金要素保障，切实把重大基础设施网络建设好。
2026年9月9日	国家发展改革委**“六张网”重大项目协调推进会**	会议提出，要充分发挥各级要素保障机制作用，主动加强与项目单位的对接，精准高效做好用地、用海、环评等要素保障，**共同推动“六张网”重大项目加快落地实施。**国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、中国人民银行、国家能源局、国家数据局、国家林草局有关司局负责同志参加会议。
2026年9月3日	国家发展改革委**“六张网”重大项目协调推进机制会**	**研究完善政银企协作机制和项目库建设。**会议专题研究推动各牵头部门和地方加快建设“六张网”项目库，加强与金融机构的信息共享，实现高效“投贷联动”；加快梳理一批具有吸引力的工程项目向社会公开推介，鼓励多元主体参与；更好发挥政府投资的撬动作用，同步完善价费形成等机制和配套支持政策，推动商业模式创新，形成共同推进“六张网”建设的合力。
2026年8月28日	国家发展改革委联合有关部门**全国投资工作推进会议**	**加力加紧做好稳投资各项工作，努力推动投资止跌回稳。**系统推进“六张网”规划建设，抓紧谋划一批重点项目，多渠道筹措项目建设资金，建立健全协调机制，确保“六张网”建设高效有序推进。
2026年8月25日	国家发展改革委**“六网协同”协调推进工作会**	**研究“六张网”投融资机制和支持政策。**会议专题研究完善“六张网”多元化投融资模式，分类细化财政、金融、投资、价格等支持政策，创新政策工具，优化政策组合，推动建立健全与不同领域不同类型工程项目相适配的投融资机制，为重大工程项目加快开工建设提供有力支撑。
2026年8月19日	国家发展改革委**“六张网”重大项目协调调度机制会**	**研究建立算力网、新型电网、新一代通信网“2+3+N”（2家电网+3家电信运营商+N家算力相关企业）协调机制**，加大统筹力度，形成工作合力，共同推动重大项目加快建设。
2026年9月7日	**工信部《信息通信行业发展“十五五”规划》**	**提升算力设施发展水平。加快全国一体化算力网建设，构建“枢纽—区域—边缘”多层次算力设施体系，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，面向场景按需部署推理算力设施，加大力度适配国产算力芯片。**深化算力自动化监测与供需匹配，提高算力资源利用率。加强算力关键共性技术研发与应用，探索太空算力技术前瞻研究及生态培育，持续完善算力标准和评价体系建设，深入实施算力强基揭榜行动。

数据来源：新华网，国家发展改革委，工信微报，国泰海通证券研究

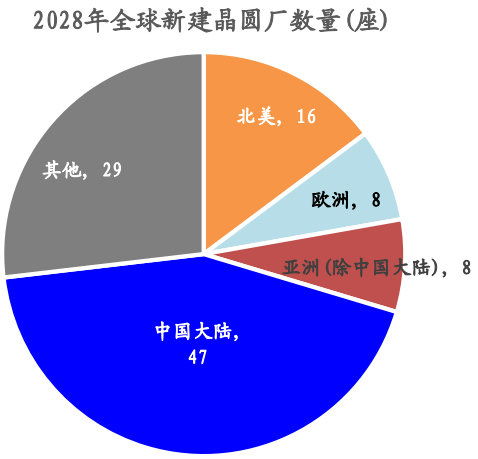
下载日志已记录，仅供内部参考

图8：国内存储与算力芯片资本开支需求驱动下，我国晶圆厂产能全球占比有望显著提升



数据来源：SEMI，国泰海通证券研究

图9：2028 年全球新建晶圆厂中，中国大陆是主要增量，占比有望达 44%



数据来源：SEMI，国泰海通证券研究

主题二：自主新技术---华为发布全球首个采用 NPO 技术的昇腾 960 超节点，催化新技术应用与配套体系升级，看好受益光互联需求的 NPO/CPO 与交换机/交换芯片

事件：

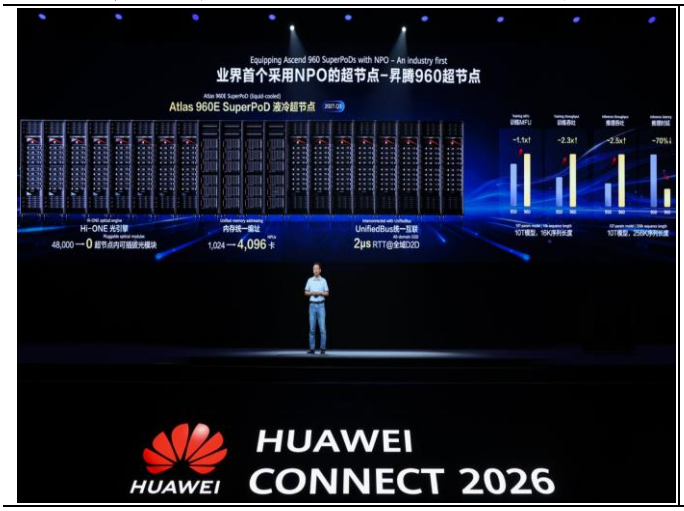
1、2026 年 9 月 17 日，华为全联接大会 2026 在上海启幕，华为副董事长、轮值董事长汪涛发表题为“智启新未来，打造智能世界的硅基黑土地”的主题演讲。发布全球首个采用 NPO 技术的超节点——昇腾 960 超节点，加速十万亿规模的大模型训练和推理。作为全球首个采用 NPO 光引擎的超节点，昇腾 960 超节点采用领先的正交架构和全液冷设计，基于灵衢实现内存统一编址，可扩展至 4096 卡规模，实现 8EFLOPS FP8、16EFLOPS FP4。昇腾 960 超节点用 5500 个 Hi-ONE，替代原本需要的 4 万 8 千颗 800G 光模块，功耗降低超 550 千瓦，系统无故障运行时间提升一倍，系统可用度达到 99.8%，加速前沿模型的训练与推理创新。（华为公司官网）

2、2026 年 8 月 27 日，英伟达管理层在财报电话会议上表示，2028 财年营收将增长约 70%，大超市场此前预估的 45%。英伟达公布的财报显示，截至 2026 年 7 月 26 日的公司 2027 财年第二财季，实现营收 962.21 亿美元，同比增长 106%，环比增长 18%。英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋指出，AI 基础设施建设正在全速推进。**Vera Rubin 现已全面投入生产**，其建设正是为了满足这一时代的需求。英伟达首席财务官 Colette Kress 表示，2028 财年营收将增长约 70%，市场此前预估 45%。黄仁勋在回答分析师提问时说道：“我们的需求增长远远高于 70%，但我们的供应使我们有信心实现 70%的增长。如果不受限制，这个数字会高得多。我们今年的同比增长达到 100%，目前的非受限需求非常巨大，因此我们只能拼命工作去获取更多产能。”（券商中国）

下载日志已记录，仅供内部参考

超节点成为 Agentic AI 时代算力基础设施的主流形态。迈入 Agentic AI 时代，更大规模 MoE 模型、更长上下文序列、更低推理时延等对算力及其基础设施提出前所未有的需求和挑战，超节点是应对这一系列挑战的关键所在。华为首次线下展出昇腾 950 超节点（Atlas 950 SuperPoD），该产品基于灵衢互联协议和超节点架构，实现业界最大 1024 卡规模，提供 1 EFLOPS FP8 、2 EFLOPS FP4 澎湃算力，拥有 256TB 全局统一内存编址空间，依托 TB 级 NPU 互联超大带宽与 3μs 超低 RTT 时延，突破集群内计算、存储等各类资源的通信瓶颈。**昇腾 384 超节点已商用落地 750 多套，规模应用于互联网、运营商、金融、教育、医疗、交通、制造等行业，也是国内唯一训练出 SOTA 模型的超节点。**

图10：华为发布采用 NPO 技术的昇腾 960 超节点



数据来源：华为公司官网

图11：昆仑芯发布超节点算力集群产品



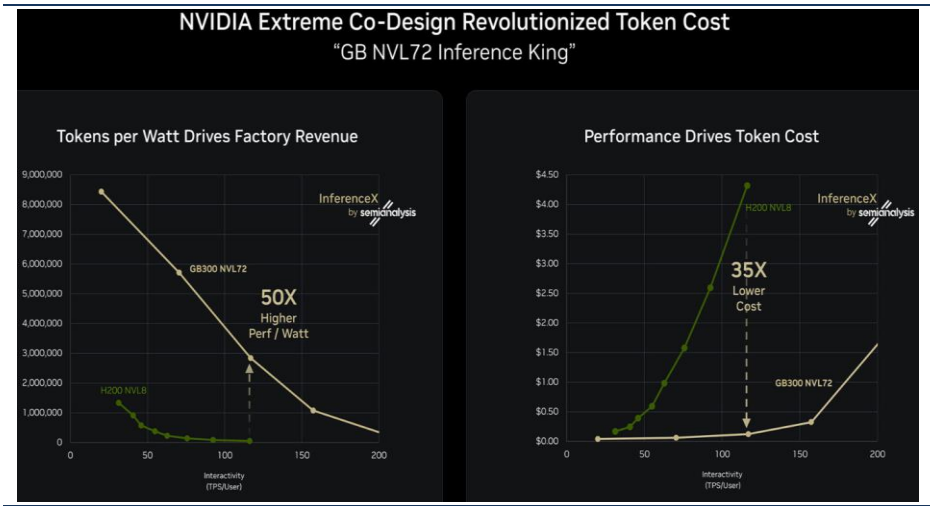
数据来源：世界人工智能大会

英伟达 Vera Rubin 平台量产，有望加速光互联新技术应用与材料体系升级。基于 NVIDIA Blackwell Ultra 构建的 AI 工厂，每兆瓦的吞吐量提升了高达 50 倍，从而将单个 Token 成本降低至 1/35，在规模化应用中完美平衡了性能、响应速度和能效。NVIDIA Vera Rubin 平台进一步推高了这条性能曲线。随着推理和智能体 AI 的规模不断扩大，基于 Vera Rubin 的系统旨在通过 LPX 技术，将每瓦特性能最高提升 35 倍，并凭借更深层次的全栈优化进一步降低 Token 成本。

在 Scale up 与 Scale out 的演进过程中，光互联的需求发生了显著变化，Scale up 聚焦单机柜或单节点内部，连接距离通常在厘米至数米级别，如 GPU 与 GPU、GPU 与 CPU 之间的短距高速互连，**采用共封装光学（CPO）、近封装光学（NPO）等芯片级光互连技术，将光引擎与计算芯片共封装，以降低时延、提高带宽密度，且对功耗和散热要求极高。**Scale out 扩展到机柜间、机架间乃至数据中心间，连接距离从数十米到数公里，需支持跨机柜、跨机架的长距离光传输。材料领域，英伟达 Vera Rubin 架构对介质损耗（Df，介质损耗因子）的要求极为严苛，追求“极低损耗”以支持超高速信号传输（如 224Gbps+）并保证信号完整性，聚四氟乙烯（PTFE）因其极低的介电损耗有望成为关键材料选择。

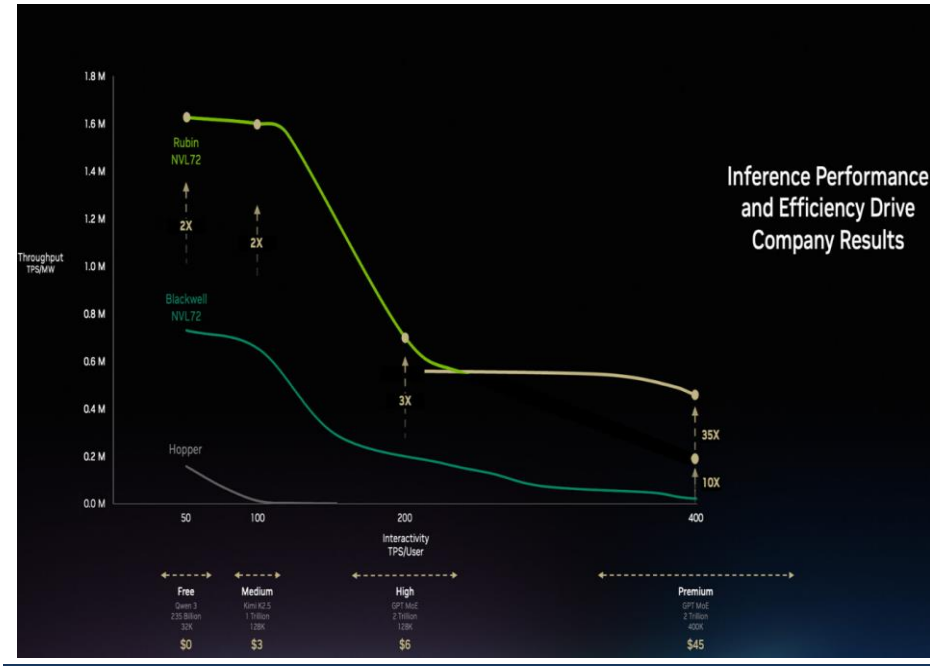
下载日志已记录，仅供内部参考

图12：NVIDIA Blackwell Ultra 大幅提升每兆瓦吞吐量，从而将单个 Token 成本降低至 1/35



数据来源：英伟达官网

图13：NVIDIA Vera Rubin 平台进一步将每瓦特性能最高提升 35 倍



数据来源：英伟达官网

主题三：先进材料---半导体制造需求高增与关键材料出口管控，催化价格上涨与加速先进材料体系国产化，看好散热材料/光刻材料/大硅片/掩膜版等

事件：

1、2026 年 9 月 15 日，工业和信息化部、国家发展改革委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。其中提到，预计到 2030 年，我国电子信息制造业在全球产业格局中发挥举足轻重作用，规模以上企业营业收入突破 30

下载日志已记录，仅供内部参考

万亿元，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业。

《规划》提出，推动集成电路全链条攻关。发展高性能处理器、高密度存储器、高可靠性模拟和数模混合芯片等高端芯片产品。提升集成电路制造水平，做精做细成熟制程，提高先进制程能力。推动先进封装测试技术开发和应用。**推动宽禁带半导体产业提质升级，推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展。**持续提升关键装备、材料和零部件供给能力，加快发展电子设计自动化工具（EDA）和知识产权核（IP 核），推进三维集成等技术突破和应用。（券商中国）

2、2026 年 8 月 28 日上午，国家发展改革委举行 8 月份新闻发布会。国家发展改革委政策研究室副主任、委新闻发言人李超出席发布会，介绍促进有效投资、《物流网建设实施方案》有关情况，并就物流网、集成电路、迎峰度夏、具身智能、煤电转型、雨带北移、中国挤压论等方面问题，回应媒体关切。发言人指出，我们将继续聚焦“十五五”规划《纲要》部署要求，发挥新型举国体制优势，**全链条推动集成电路关键核心技术攻关取得决定性突破**，促进集成电路产业高质量发展，为推动中国经济持续向新向优向好发展做出更大贡献。（国家发展改革委）

3、2026 年 8 月 28 日，覆铜板龙头建滔积层板下发最新涨价通知。涨价函显示，近期由于上游物料玻璃布、铜箔等核心主材供应紧缺、价格大幅上涨，自即日起，公司对所有厚度 FR-4 覆铜板统一涨价 10%；PP 半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布 PP 涨价 10%，7628 以下薄布 PP 涨价 20%。这已是建滔积层板年内第七次发布涨价函，自 3 月以来基本每月一涨。经初步计算，仅 FR-4 覆铜板（1.3mm 以上厚度）按复利计算，累计涨幅便已超 100%。（财联社）

4、日本经济产业省（METI）于 2026 年 6 月 16 日公布修订后的《输出贸易管理令》，宣布新增对华出口管制措施。该管制针对高端机床相关技术，尤其是五轴数控机床，将于 2026 年 8 月 16 日正式生效。此举标志着日本在半导体设备之后，进一步收紧对华高端制造业核心技术的出口限制。（海峡导报大财经）

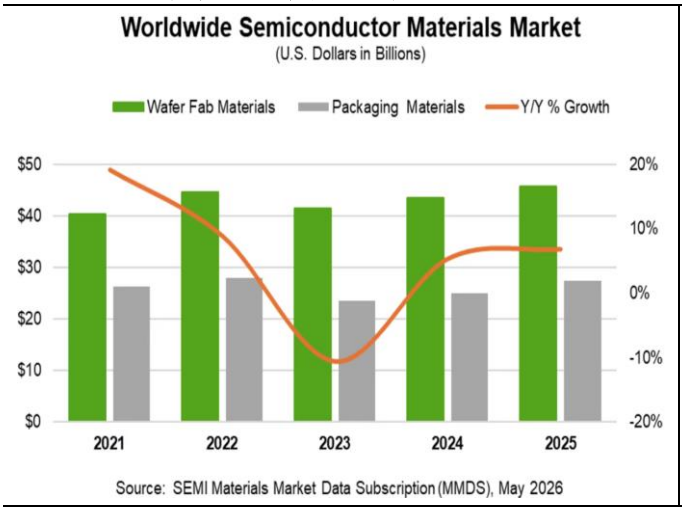
5、2026 年 8 月 13 日据集微网报告，全球 ABF 膜绝对垄断巨头日本味之素，正式通知中国大陆客户：削减 30% ABF 膜供货量。该材料在全球 ABF 膜市场占据 95%的绝对份额，是高性能 IC 载板和算力芯片封装的核心绝缘层。（集微网）

全球半导体材料市场需求高增，中国大陆半导体材料收入增速与规模保持领先。据 SEMI，2025 年全球半导体材料市场销售额同比增长 6.8%，达到 732 亿美元。晶圆制造材料和封装材料两大板块均实现增长，反映出更高的工艺复杂度、先进制程需求，以及高性能计算和高带宽存储制造领域的持续投资。2025 年全球晶圆制造材料销售额增长 5.4%，达到 458 亿美元。光刻相关材料（包括光掩膜、光刻胶及辅助材料）以及湿化学品均实现强劲的双位数增长。2025 年全球封装材料销售额增长 9.3%，达到 274 亿美元。基板和键合线引领增长，其中键合线受到金价上涨的支撑，先进基板则受益于强

下载日志已记录，仅供内部参考

劲需求。分区域看，中国台湾地区连续第 16 年保持全球最大半导体材料消费地区位置，2025 年销售额达 217 亿美元；中国大陆以 156 亿美元的销售额排名第二；韩国以 112 亿美元销售额排名第三。

图14：全球半导体材料市场销售额稳健增长



数据来源：Semi

图15：中国大陆半导体材料收入增速与规模领先

Region	2025	YoY % Growth
North America	$6.2	10.7%
Europe	$4.2	-6.0%
Japan	$6.8	2.3%
Chinese Taiwan	$21.7	8.6%
South Korea	$11.2	2.4%
Chinese Mainland	$15.6	12.5%
ROW	$7.5	6.7%
Total	**$73.2**	**6.8%**

Source: SEMI Materials Market Data Subscription (MMDS), May 2026

数据来源：Semi

图16：半导体制造需求高增叠加关键材料出口管控，有望催化材料自主化

细分领域	日本主要厂商	国内主要厂商	国内依赖程度
光刻胶	JSR、东京应化(TOK)、信越化学、富士胶片(Fujifilm)	**南大光电**、晶瑞电材、鼎龙股份	**高**
CMP抛光液/抛光垫	Fujimi、Resonac、Fujibo	**安集科技、鼎龙股份**	高
12英寸大硅片	信越化学、SUMCO	**沪硅产业**、立昂微	**高**
电子特气	大阳日酸、关东电化、昭和电工	**华特气体、中船特气**	中等
靶材	JX金属、东曹	**江丰电子**	较低
湿电子化学品	三菱化学、住友化学、关东化学	**兴福电子、晶瑞电材**、江化微、中巨芯	较低

数据来源：国泰海通证券研究

主题四：AI4S---AI 工具加速驱动创新药物研发，头部大模型公司加速布局，产业投融资高热度，看好具备前沿模型开发能力的模型公司与头部创新药企

事件：

1、2026 年 9 月 16 日，诺和诺德将与人工智能公司 Anthropic 展开合作，利用 AI 工具推进药物研发。诺和诺德当地时间周三表示，公司将使用 Anthropic 面向科学研究打造的平台 Claude Science，以加快新药发现和开发

下载日志已记录，仅供内部参考

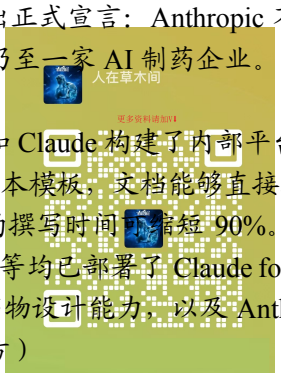
进程，并重点解决双方认为能够产生最大实际影响的科学问题。

诺和诺德首席执行官 Mike Doustdar 表示："AI 可以帮助我们提高研发效率，缩短从科研到产品上市的时间。但除此之外，AI 工具还可以带来全新的科学研究机会，并帮助我们更好地推理和理解人体生物学以及药物作用机制。"诺和诺德表示，在与 Anthropic 的合作中，公司将测试 Claude Science，以帮助解决科学研究中的问题。此外，诺和诺德还计划利用 Anthropic 的模型，进一步提升 AI 驱动的软件开发能力。

Anthropic 联合创始人兼首席执行官 Dario Amodei 表示："AI 能力不断提升，有可能将原本需要一个世纪才能实现的生物学和医学突破，压缩到十年之内。我们可以缩短研发周期、改善研发成果，并发现能够显著改善人类生活的药物和治疗方法。这正是我们与诺和诺德开展合作希望实现的目标。"（科创板日报）

2、2026 年 9 月 16 日，由字节跳动分拆出来的 AI 制药公司新生探途（Anew Labs）宣布完成首轮天使轮融资，融资金额 2.9 亿美元，投后估值达 15 亿美元。融资完成后，字节跳动保留 56%股份，保持控股地位。据悉，新生探途前身为字节跳动内部药物发现团队，由 AI4S 算法人才和资深制药领域专家构成，2021 年由刘凯牵头组建，核心团队约 50 人。2026 年 6 月，上述业务从字节跳动分拆独立运营后，核心团队整体迁入新主体。融资涵盖了红杉中国、IDG 资本、高瓴创投、五源资本、高榕创投、春华创投等头部投资机构，中国生物制药等多家医药产业资本也参与其中。（科创板日报）

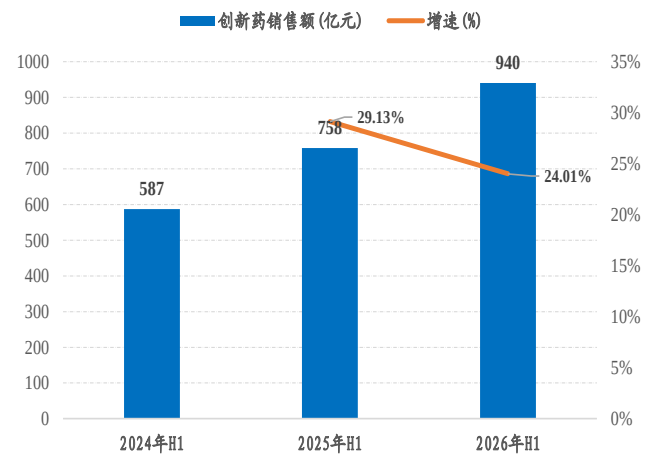
3、2026 年 9 月 10 日，据外媒 Endpoints News 报道，Anthropic 近期最新发布了招聘生物制药方向的企业发展负责人，并表示"这一岗位处于前沿 AI 研究与生命科学的交汇点，将对 Anthropic 在其最具战略意义领域的增长产生直接影响。" 2026 年 4 月至 6 月底，Anthropic 密集布局生物科技领域，业内称"100 天闪电行动"，其布局也逐步显现。4 亿美元收购 Coefficient Bio，是这场行动的"第一枪"。Coefficient Bio 是成立不足一年的小型初创公司，核心团队成员来自基因泰克的 Prescient Design 计算药物发现团队，研究目标是"生物领域的人工超级智能（ASI for Science）"。6 月 30 日，Anthropic 举办"AI for Science"发布会，发出正式宣言：Anthropic 不只想做"AI 助手"，更希望做 AI 药物发现引擎，乃至一家 AI 制药企业。



诺和诺德称，基于 Amazon Bedrock 和 Claude 构建了内部平台 NovoScribe，采用 RAG 架构结合领域专家审定文本模板，文档能够直接进入人工审核和审批流程，临床研究报告（CSR）的撰写时间已缩短 90%。此外，赛诺菲、艾伯维、阿斯利康、BMS、Genmab 等均已部署了 Claude for Sciences。但更引起关注的是 Claude Mythos 5 的药物设计能力，以及 Anthropic 管理层宣布"正在自主研发药物"。（医药魔方）

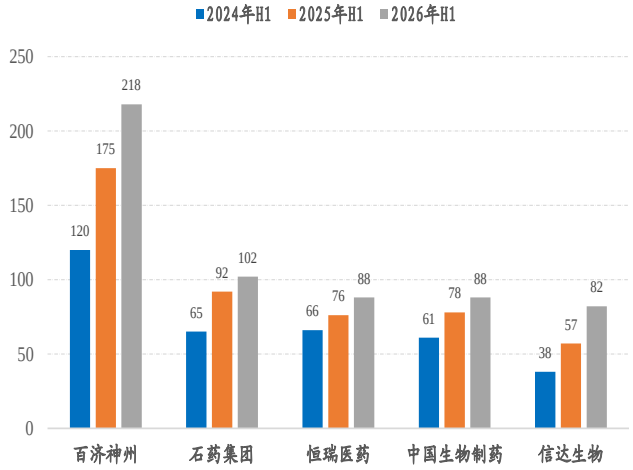
下载日志已记录，仅供内部参考

图17：27 家头部药企上半年创新药销售额大增



数据来源：赛柏蓝，国泰海通证券研究

图18：近三年头部药企创新药销售额高增(亿元)



数据来源：赛柏蓝，国泰海通证券研究

三、风险提示

关键技术商业化进程低于预期。产业政策和应用端推进节奏不及预期，关注科技领域技术成果转化和商业化进程。**地缘政治相关风险。**地缘冲突带来能源供应不确定性，压制市场风险偏好。

下载日志已记录，仅供内部参考

本公司是本报告所述安集科技(688019),沪硅产业(688126),中船特气(688146),百济神州(688235),寒武纪(688256)的做市券商。本报告系本公司分析师根据安集科技(688019),沪硅产业(688126),中船特气(688146),百济神州(688235),寒武纪(688256)公开信息所做的独立判断。

下载日志已记录，仅供内部参考

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）授权客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰海通证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。

以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 10%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%～10%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%～5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
	无评级	对于个股未来市场表现与基准指数相比无明确观点
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰海通证券研究所

地址 上海市黄浦区中山南路 888 号 邮编 200011 电话 （021）38676666